# SMT工艺工程师的个人求职简历模板[五篇材料]

来源：网络 作者：静谧旋律 更新时间：2024-09-05

*第一篇：SMT工艺工程师的个人求职简历模板求职者在编写个人简历之前需要注意招聘信息中的潜在要求，因为个人简历需要针对招聘信息来写。在求职过程中个人简历写的如何，直接关系到求职能不能成功通过，要编写优秀的个人简历需要对求职信息了解、对求职目...*

**第一篇：SMT工艺工程师的个人求职简历模板**

求职者在编写个人简历之前需要注意招聘信息中的潜在要求，因为个人简历需要针对招聘信息来写。在求职过程中个人简历写的如何，直接关系到求职能不能成功通过，要编写优秀的个人简历需要对求职信息了解、对求职目标了解，还需要对自己有所了解。

姓　　名： 胡先生 性　　别： 男

婚姻状况： 未婚 民　　族： 汉族

户　　籍： 湖北-随州 年　　龄： 23

现所在地： 广东-珠海 身　　高： 178cm

希望地区： 广东-珠海

希望岗位： 工业/工厂类-生产管理主管/督导

工业/工厂类-生产经理/主管

工业/工厂类-车间经理/主管

寻求职位： SMT副主管、SMT主管

教育经历

2024-09 ～ 2024-07 湖北职业技术学院 机电一体化原理与运用 本科

2024-02 ～ 2024-11 广东技术师范学院 SMT工程设备管理与维护 本科

培训经历

2024-02 ～ 2024-11 广东技术师范学院工业实训中心 SMT贴片生产线实际生产 SMT工程培训证书

\*\*公司(2024-04 ～ 至今)

公司性质： 跨国公司(集团)行业类别： 通信、电信运营、增值服务

担任职位： SMT工艺工程师 岗位类别： 移动通信工程师

工作描述： 主要从事半导体封装后测试用线路板，晶元测试用线路板的电子元器件焊接的工艺审核，具体为根据设计资料和相关文件，判断产品的回流工艺(有铅焊接，无铅焊接，手工焊接，机械焊接等)找出焊接中的工艺难点和其他因素对焊接的影响(包括线路板基材，电子物料承受温度，焊接对信号接收影响，继电器安装，集成电路的安装等)，同时做好生产时需要的相关工艺流程文件，钢网治具，炉温曲线等，在生产时对产品的生产的各个过程(焗板.印刷.贴片.检查.回流.焊接.洗板.机装.测量.目检.物料测试.线路测试.成品装框包装)进行实时监控记录跟进，做到对每一块板进行生产记录，发现问题，分析问题，解决问题，持续跟进。

\*\*公司(2024-02 ～ 2024-02)

公司性质： 私营企业 行业类别： 通信、电信运营、增值服务

担任职位： SMT主管 岗位类别： 数据通信工程师

工作描述： 1.与市场部密切合作沟通，组织订单评审，按排每月的生产计划，每周及时调整生产计划

2.每日跟近生产进度，并协调各部门完成生产任务，管理成品交付及异常的沟通及处理。

3.协调生产，组织物料的使用及流动，平衡产能，合理安排调配人员、机器设备、物料等

资源，确保客户交期。

4.将每月生产计划及时反馈给采购部采购物料，并跟踪物料库存情况，即时调整生产计划

5.物料需求计划的审批，存货量及呆滞物料的控制及处理，生产异常补料的审核等。

6.车间设备的维护保养(车间的主要贴片设备为JUKI2050 4台，FUJI-CP642 2台 劲拓回流焊2

台)包括设备的编程优化，设备零部件的更换等

离职原因： 工厂迁移

\*\*公司(2024-12 ～ 2024-02)

公司性质： 外资企业 行业类别： 通讯、电信、网络设备

担任职位： SMT生产领班/PMC领班 岗位类别： 其他相关职位

工作描述： 1.与市场部密切合作沟通，组织订单评审，按排每月的生产计划，每周及时调整生产计划

2.每日跟近生产进度，并协调各部门完成生产任务，管理成品交付及异常的沟通及处理。

3.协调生产，组织物料的使用及流动，平衡产能，合理安排调配人员、机器设备、物料等

资源，确保客户交期。

4.将每月生产计划及时反馈给采购部采购物料，并跟踪物料库存情况，即时调整生产计划

5.物料需求计划的审批，存货量及呆滞物料的控制及处理，生产异常补料的审核等。

离职原因： 无法升职

\*\*公司(2024-07 ～ 2024-11)

公司性质： 外资企业 行业类别： 通讯、电信、网络设备

担任职位： SMT-PE技术员 岗位类别： 其他相关职位

工作描述： 1.SMT设备的日常维护(主要设备为DEK全自动印刷机，西门子HS5060 D系列 X系列贴片机，HELLER18系列回流焊，等);

2.SMT工艺缺陷改善，新产品导入，NPI试产.作业指导书的编写，炉温曲线的制作等;

3.SMT设计准则订定与发布(含PCB PAD Layout,钢板开孔);定义及修定SMT作业及各项操作条件规范和各项管制办法;

4.SMT间接材料的评估及承认;源材不良的判定与反馈和改善;

离职原因： 工资低

技能专长

专业职称： SMT生产管理，工艺管控，设备维护

计算机水平： 中级

计算机详细技能： 1.SMT4年之久，一直围绕SMT这个核心进行发展，包括SMT的生产布局分布，人力资源的分配与管控，人员考核，技能评估，2.SMT工艺管控，各个工位的难点掌握，分析，工艺异常的发现，分析，解决，跟踪，3.SMT常用设备的维护，精通JUKI FX\*\*\*贴片机，了解YAMAHA YG100 等，FUJU CP642 CP643等贴片机，颈托回流焊，AOI，等

技能专长： 1.SMT4年之久，一直围绕SMT这个核心进行发展，包括SMT的生产布局分布，人力资源的分配与管控，人员考核，技能评估，2.SMT工艺管控，各个工位的难点掌握，分析，工艺异常的发现，分析，解决，跟踪，3.SMT常用设备的维护，精通JUKI FX\*\*\*贴片机，了解YAMAHA YG100 等，FUJU CP642 CP643等贴片机，颈托回流焊，AOI，等

语言能力

普通话： 流利 粤语： 一般

英语水平： 英语专业 4 口语流利

英语： 良好

求职意向

发展方向： 1,.SMT车间的人力资源管理，车间给各个岗位的技能考核，评估，人力资源合理分配，2.SMT车间在线设备操作，管理，维护(包括印刷机，贴片机，回流焊，AOI，接驳台，转接台，X RYY,测试机等)

3.SMT工艺制程管理与改善，在线效率的提升等，包括SMT钢网开孔规范，GERBER文件的审核处理，在线不良品的分析，解决与改善，QC7大手法的灵活运用，4.产线效率的提升，根据不同时期市场活跃度和订单量，合理安排和掌控人员的数量，力求在保证生产顺畅的同时，减少人力资源成本开支，谋求效益最大化。

其他要求： 1.精通SMT车间的人力资源管理，可以利用最少的人力资源，发挥最大的工作能力，从而提供生产效率，减少人力资源成本，为企业创造更具有竞争力的价值。

2.劳动力资源的合理利用，就可以达到无限的规模可以被重复的执行，最终创造实际的经济效益。

自身情况

自我评价： 希望在SMT行业长久的发展，更多的了解FPC,PCB 在SMT工序的难点工艺，不断的在实际生产中总结经验，为企业解决实际问题，从而创造丰富的价值。

**第二篇：SMT试题 -SMT 工艺工程师**

SMT 工艺工程测试题

姓名：

得分：

一、判断题:(10分)1.锡膏由焊剂和焊料组成,焊剂是合金粉末的载体，它与合金粉末的相对比重相差极大，为了保证良好地混合在一起，本身应具备高黏度;而焊料指的材料是软钎焊及其材料.（）2.钢网厚度的选取一般来说取决于IC的Pitch值.（）3.设定一个回流温度曲线要考虑的因素有很多，一般包括所使用的锡膏特性，回流炉的特点等,但不需考虑PCB板的特性.()4.PCB板阻焊膜起泡是由于阻焊膜与PCB基材之间存在气体/水蒸气/脏物造成.()5.通过适当降低PCB的Tg值和增加PCB板厚度可以改善PCB板扭曲问题.（）6.对于制作插机操作指导书时,对插机元件的安排应”先大后小, 从左到右”的顺序.()7.预热温度过低或助焊剂喷雾过少会造成PCBA板过波峰焊后板面有锡网产生.()8.后加过程中烙铁温度温度设置过高,会加快烙铁头的氧化,缩短烙铁头的使用寿命.()9.发现锡线溅锡现象, 可以通过对锡线开一个小的”V”槽来改善.()10.锡膏印刷机的刮刀速度可以改变锡膏厚度, 速度越快厚度越薄.（）

二、单选题(30)1.PCB板的烘烤温度和时间一般为()A.125℃,4H

B.115℃,1H

C.125℃,2H

D.115℃,3H 2.从冰箱中取出的锡膏,一般要求在室温中回温()

A.2H

B.4到8H

C.6H以内

D.1H 3.使用无铅锡膏,钢网开口面积为PCB板焊盘尺寸的()

A.90%以上

B.75%

C.80%

D.70%以上

4.根据IPC的判断标准,条码暗码的可读性通过条码扫描设备扫描,如果扫描次数超过(),就可以判断该条码为不良.A.1次

B.2~3次

C.4次

D.4次以上

5.根据IPC的标准,PCB板上的丝印字体必须满足的最低接受标准是()

A.字体必须清楚

B.字体模糊,但可辨别

C.字体连续/清晰

D.字体无要求 6.钢网厚度为0.15mm, 印刷锡膏的厚度一般为()

A.0.5~0.18mm

B.0.9~0.23mm

C.0.13~0.25mm

D.0.9~0.18mm 7.96.5%Sn-3%Ag-0.5%Cu的锡膏的熔点一般为()

A.183℃

B.230℃

C.217℃

D.245℃ 8.在无铅生产中,一般要求烙铁的功率为()

A.55W

B.60W

C.70W以上

D.以上都可以 9.在有铅波峰焊生产中,要求过波峰的时间为()

A.2~3秒

B.3~5秒

C.5秒以上

D.以上都是

10.在无铅生产中,按IPC的标准通孔上锡必须满足PCB板厚度的()

A.55%以上

B.100%

C.70%以上

D.75%以上

11.普通SMT产品回流焊的升温区升温速度要求:()A.5℃/Sec

C.>2℃/Sec

D.基本信息：

姓名：xx

性别：男

出生年月：xx年xx月

身高：176cm

现在住址：xx

婚姻状况：未婚

毕业院校：xxxx大学

专业：机械设计制造及其自动化

联系电话：xx

电子信箱：xx

应聘岗位：过程工艺工程师

教育培训：

20xx年xx月——20xx年xx月 xxxx省xxxx大学机械设计专业（英语四级，计算机二级）

20xx年xx月——20xx年xx月 xxxx省xxxx县高级中学

20xx年xx月——20xx年xx月 xxxx省xxxx县太平中学

工作经历：

20xx年xx月——至今任职于一汽xxxx汽车有限公司

简介：

一、20xx年xx月——20xx年xx月，在各生产车间进行实习。熟悉冲压、涂装、焊装、装配车间的汽车生产工艺。

二、20xx年xx月——20xx年xx月，在生产部从事生产控制、精益生产方式的推进工作。曾跟随一汽采购部改善专家对xxxx动力和xxxx通机进行了半个月的现场改善和指导。熟练掌握精益生产方式的基础知识，掌握作业手顺书、作业要领书、工序能力表等的编制方法。对各车间进行现场5S管理，负责日常改善工作。

三、20xx年xx月——现在，任装配车间现场工程师，负责现场工艺管理和标准作业的.制定维护工作。参与了车间节拍变更工作，从人、机、料、法等环节对工程布置进行制定，并进行对策的跟踪、实施和确认。对装配车间15个工位的标准作业进行了修订。对现场作业、设备保障能力、关键点保证、人员资质、工件供应情况进行了审核。共提出了18项改进要求，制定了10项措施方案，有效的提高了工区的可动率和过程质量保证能力。

个人概述：

诚实、守信、思维敏捷，学习能力强，能吃苦，具有良好的团队合作精神。由于日常工作经常和日本的工作人员接触，学习了丰田人员认真、细致的工作方法，养成了良好的工作习惯，拥有较好的知识结构。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找